

## DDR4 DIMM

TE 内部编号 2309411-1

SO DIMM Sockets, Small Outline (SO), Stack Height .315 in [8 mm],  
Right Angle Module Orientation, 260 Position, DDR4 DIMM[在 TE 官网查看>](#)[连接器](#) > [接口插槽](#) > [内存插槽](#) > [SO DIMM 插槽](#) > [DDR4 SO DIMM Sockets](#)

DRAM 类型: 小型 (SO)

堆叠高度: 8 mm [ .315 in ]

模块方向: 直角

位数: 260

中心线 (间距) : .5 mm, 5.4 mm, 6.1 mm [ .02 in ]

[所有 DDR4 SO DIMM Sockets \(39\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板
DRAM 类型	小型 (SO)

### 结构特性

钥匙数	1
行数	2
模块方向	直角
位数	260

### 电气特征

DRAM 电压	1.2 V
---------	-------

### 信号特征

SGRAM 电压	1.2 V
----------	-------

### 主体特性

弹射器位置	两端
固定柱材料	不锈钢
插销材料	高温热塑塑料



固定柱位置	两端
-------	----

模块钥匙类型	左偏移
--------	-----

弹射器类型	锁定
-------	----

连接器外形	高
-------	---

#### 接触件特性

内存插槽类型	内存卡
--------	-----

端子底板材料	镍
--------	---

PCB 端子端接区域电镀材料	镀金
----------------	----

端子基材	铜合金
------	-----

端子额定电流 (最大值)	.5 A
--------------	------

端子接触部电镀材料	镀金
-----------	----

#### 端接特性

插入种类	凸轮
------	----

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

#### 机械附件

接合对准类型	标准键控
--------	------

PCB 安装固定	带有
----------	----

PCB 安装固定类型	焊钉
------------	----

连接器安装类型	板安装
---------	-----

#### 壳体特性

外壳材料	高温热塑塑料
------	--------

壳体颜色	黑色
------	----

中心线 (间距)	.5 mm, 5.4 mm, 6.1 mm [.02 in]
----------	--------------------------------

#### 尺寸

堆叠高度	8 mm [.315 in]
------	----------------

行间距	8.2 mm [.322 in]
-----	------------------

#### 使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C [-67 – 185 °F]
--------	----------------------------

#### 操作/应用

电路应用	电源
------	----

#### 行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

## 包装特性

封装数量	500
封装方法	卷带包装, 卷带包装

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | [DDR4 DIMM](#)

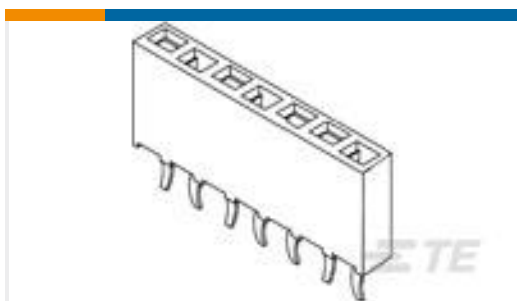
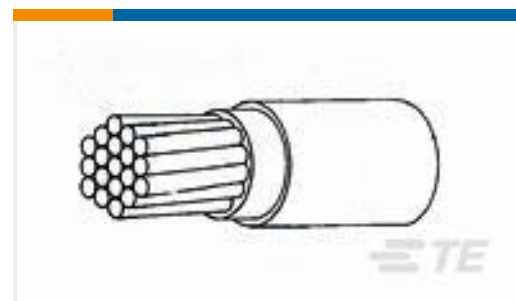


DIMM 插槽(69)



SO DIMM 插槽(39)

## 客户还购买了

TE 产品编号5414907-1  
JACK,PCB,75 OHM,NCTE 产品编号2-1623730-7  
BCHE 4 W 6R8 10%TE 产品编号2309408-1  
DDR4 SODIMM 260P 4.0H RVSTE 产品编号364715-E  
DRCBTB 1,27 68 M BTB20 18,2 137 \*  
094 TRTE 产品编号215297-3  
3P HV100 REC CON. TE, 7.0MMTE 产品编号2-1761608-5  
IDC LOW PRO HDR 14P VERT SHT LTE 产品编号282022-026  
44A0111-20-2TE 产品编号2-1445053-2  
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LFTE 产品编号5-2176345-0  
CRGCQ 1210 120K 1%

## 文档

### 产品图纸

[DDR4 SODIMM 260P 8.0H STD](#)

[英文版本](#)

### CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2309411-1\\_1.2d\\_dxf.zip](#)



英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2309411-1\\_1.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2309411-1\\_1.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

**产品规格**

**应用规格**

英文版本